

【19】中華民國

【12】發明公開公報 (A)

【11】公開編號：200937677

申請實體審查：有

【43】公開日：中華民國98(2009)年9月1日

【51】國際專利分類 Int. Cl. : **H01L33/00 (2006.01)**

【54】發明名稱：發光二極體晶片及其製造方法

LIGHT EMITTING DIODE CHIP AND METHOD FOR FABRICATING THE SAME

【21】申請案號：097106921

【22】申請日：中華民國97(2008)年2月27日

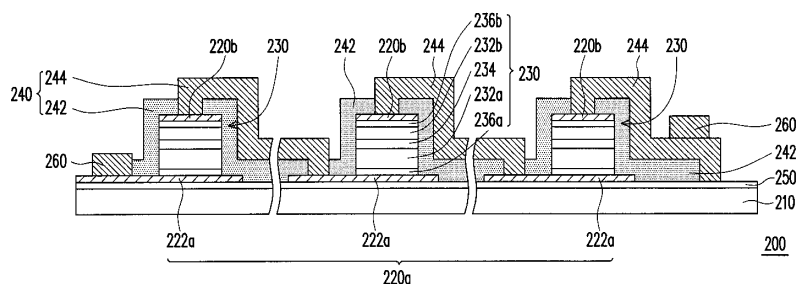
【72】發明人：許世昌 SHEI, SHIH CHANG；林諧彥 LIN, HSIEH YEN

【71】申請人：國立臺南大學 NATIONAL UNIVERSITY OF TAINAN
臺南市中西區樹林街2段33號

【74】代理人：詹銘文；蕭錫清

【57】發明摘要

一種發光二極體晶片包括一基板、一線路層、多個電極、多個二極體元件以及一內連線層。線路層配置於基板上，而這些電極配置線路層的上方。這些二極體元件連接於線路層與這些電極之間。內連線層包括一保護層以及多條走線。保護層覆蓋線路層、這些電極以及這些二極體元件。保護層局部暴露線路層與這些電極。這些走線配置於這些二極體元件上。這些走線與線路層以及這些電極連接，而這些二極體元件透過這些走線而彼此電性連接。



代表圖式

200：發光二極體晶片
210：基板
220a：線路層
220b：電極
222a：導電層
230：二極體元件
232a：第一型摻雜半導體層
232b：第二型摻雜半導體層
234：主動層
236a：第一歐姆接觸層
236b：第二歐姆接觸層
240：內連線層
242：保護層
244：走線
250：絕緣層

260：打線接墊